

〈技術トピックス〉

ウエハレベルパッケージ新工場稼働

2002年秋から量産納入を開始したウエハレベルパッケージ（WLP）受託加工サービスは、その後順調に生産数量が増え、需要が当初整備した開発を兼ねた製造ラインの生産能力を超える見込みとなった。このため、現行ラインのある佐倉事業所内に、現行ラインとは別にWLPの新工場を整備し、2004年4月より稼働させている。これにより処理能力は5,000枚／月産に引き上げられた。この新工場はさらに現行ラインの設備を収容すると同時に新たな設備投資も行い、2004年度末には7,000枚／月産の生産能力を有することになる。

当社が本格的に量産を開始した2003年からWLP加工した電源ICやEEPROMが、携帯電話等に多用されるようになっており、今後も顧客の

小型化・高密度実装の要求と相まって、需要が大幅に拡大するものと思われる。また、当社の基幹商品となったフレキシブルプリント回路（FPC）基板の納入形態として表面実装部品を実装したモジュールが急増しており、そこでもICチップの搭載工法の一つとして封止およびテスト済みで扱いやすいWLPを利用することが期待されている。このため、薄肉化のためのウエハバックグランドや表面実装部品搭載機にそのまま装填できる形態にするための後工程（ダイシング、テープ&リールパッキング等）もあわせて受託できるように整備を進めている。

（プリント回路事業部ウエハレベル
パッケージ部 滝沢）



図1 新工場内クリーンルーム

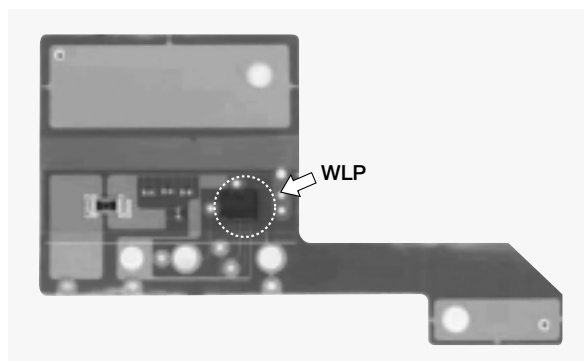


図2 WLP化したチップをFPC上に実装した例
（当社評価用基板）

【お問い合わせ】

TEL：03-5606-1194 FAX：03-5606-2418

E-mail：device@rd.fujikura.co.jp